



## MSOP8 封装型式

### 1、封装简介

关于 OBC 塑封模块，它是一种专门用于车载充电器 (OBC) 的集成化功率半导体组件。它通过先进的塑封工艺，将多个 SiC、SJ 或 IGBT 芯片、连接基板等集成在一个紧凑的封装内，主要目的是为了实现 OBC 的高功率密度、高效率和小型化设计。



### 2、结构特点：

**卓越的散热与功率密度：**模块内部采用高热导率 DBC 陶瓷片，并优化布局，显著降低热阻。这使得芯片工作温度更低，或在相同体积下能通过更大电流。

**提升系统集成度与可靠性：**模块在出厂前已完成内部绝缘和性能测试，并大幅减少了外部 PCB 上的连线、爬电距离和分立器件数量，从而简化了设计，提高了整机可靠性。

**简化开发与生产：**由于模块是预集成的标准化组件，可以缩短开发周期，降低在布局、散热和绝缘处理上的设计风险。在产线上也减少了贴片和焊接工序，有利于自动化生产。



3、应用场景：

车载充电器（OBC）、DC-DC 转换器、电动压缩机等

